



Предназначены для посадки кристаллов в производстве полупроводниковых приборов, интегральных схем и монтажа изделий пьезоэлектроники. Применяются в электро-, радиотехнической промышленности, приборостроении и электронике. Использование клеев ТОК позволило автоматизировать процесс посадки кристаллов полупроводниковых приборов с термокомпрессионной разваркой выводов.

Представляют собой композиции на основе эпоксидного связующего, активного разбавителя, наполнителя (мелкодисперсное серебро) и отвердителя.

Клеи марок ТОК хранят при температуре не более -6 °С.

Производятся в соответствии с ТУ ШКФЛО.028.002.

Технические характеристики	ТОК-1	ТОК-2
Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +200 360 (в течение 15 мин.)	
Количество компонентов	2	1
Условная вязкость по методу «круга»	5-7	4-7
Коэффициент тиксотропности	15,4	5,3
Жизнеспособность, сут., не менее	2	60
Удельное объемное электрическое сопротивление. Ом·см, не более	5·10 ⁻⁴	5·10 ⁻⁴
Предел прочности при сдвиге на паре «сталь-сталь», МПа, не менее	7,0	8,0
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не менее	4	2
Коррозионная активность по отношению к меди и алюминию, балл, не более	1	0



Режим отверждения, °C/ч.	120/5-6 или 150/1-2*	150/4 или 170/2 или 200/1
Срок сохраняемости при температуре не более -6 °C, мес., не менее	6	6; 2 (для клея с вязкос-тью 4)

Технология применения клея ТОК-2:

Перед применением, после хранения в морозильнике, клеи марок ТОК выдерживают при температуре (25 ± 10) °C в течение 2 ч., затем тщательно перемешивают, т. к. наполнитель может оседать. Режимы отверждения приведены в таблице.

По вопросам приобретения Клей ТОК-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: